

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103289682 A

(43) 申请公布日 2013.09.11

(21) 申请号 201210047862.0

(22) 申请日 2012.02.28

(71) 申请人 海洋王照明科技股份有限公司

地址 518100 广东省深圳市南山区南海大道
海王大厦 A 座 22 层

申请人 深圳市海洋王照明技术有限公司

(72) 发明人 周明杰 王平 陈吉星 黄辉

(74) 专利代理机构 广州华进联合专利商标代理
有限公司 44224

代理人 何平

(51) Int. Cl.

C09K 11/56 (2006.01)

H01L 33/50 (2010.01)

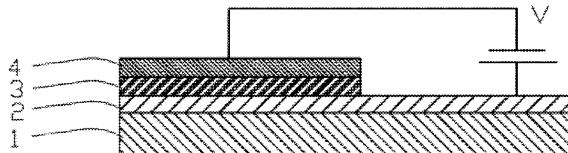
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

氟铜共掺杂硫化钙发光材料、制备方法及其
应用

(57) 摘要

一种氟铜共掺杂硫化钙发光材料，其化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ ，其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$ ， $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。该氟铜共掺杂硫化钙发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱 (EL) 中，在 437nm 波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的制备方法及其应用。



1. 一种氟铜共掺杂硫化钙发光材料,其特征在于:其化学式为 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$,其中 CaS 是基质, Cu 元素是激活元素, $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

2. 一种氟铜共掺杂硫化钙发光材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

根据 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS , CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀,其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$;及

将混合均匀的粉体在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时即得到化学式为 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$ 的氟铜共掺杂硫化钙发光材料。

3. 一种氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜,其特征在于,该氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$,其中, CaS 是基质, Cu 元素是激活元素, $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

4. 一种氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

根据 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS , CuS 和 CaF_2 并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时制成靶材,其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$;

将所述靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体,并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$;及

调整磁控溅射镀膜工艺参数为:基靶间距为 $50\text{mm} \sim 90\text{mm}$,磁控溅射工作压强 $0.2\text{Pa} \sim 1.5\text{Pa}$,工作气体的流量为 $15\text{sccm} \sim 20\text{sccm}$,衬底温度为 $200^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$,接着进行制膜,得到化学式为 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$ 的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜。

5. 根据权利要求 4 所述的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的制备方法,其特征在于,还包括步骤:将所述氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜于 $500^\circ\text{C} \sim 800^\circ\text{C}$ 下真空退火处理 $0.5\text{h} \sim 3\text{h}$ 。

6. 根据权利要求 4 所述的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的制备方法,其特征在于,所述真空腔体的真空度为 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$,基靶间距为 60mm ,磁控溅射工作压强为 1Pa ,工作气体为氩气,工作气体的流量为 20sccm ,衬底温度为 450°C 。

7. 一种薄膜电致发光器件,该薄膜电致发光器件包括依次层叠的衬底、阳极层、发光层以及阴极层,其特征在于,所述发光层的材料为氟铜共掺杂硫化钙发光材料,该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的化学式为 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$,其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

8. 一种薄膜电致发光器件的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

提供具有阳极的衬底;

在所述阳极上形成发光层,所述发光层的材料为氟铜共掺杂硫化钙发光材料,该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的化学式为 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$,其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$;

在所述发光层上形成阴极。

9. 根据权利要求 8 所述的薄膜电致发光器件的制备方法,其特征在于,所述发光层的制备包括以下步骤:

根据 $\text{CaS:xCu}^{2+}, \text{yF}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS , CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时制成靶材,其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$;

将所述靶材以及所述衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体,并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$;

调整磁控溅射镀膜工艺参数为：基靶间距为 50mm～90mm，磁控溅射工作压强 0.2Pa～1.5Pa，工作气体的流量为 15sccm～20sccm，衬底温度为 200℃～500℃，接着进行制膜，在所述阳极上形成发光层。

10. 根据权利要求 9 所述的薄膜电致发光器件的制备方法，其特征在于，所述发光层的制备还包括步骤：将所述发光层于 500℃～800℃下真空退火处理 0.5h～3h。

氟铜共掺杂硫化钙发光材料、制备方法及其应用

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种氟铜共掺杂硫化钙发光材料、其制备方法、氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜、其制备方法、薄膜电致发光器件及其制备方法。

【背景技术】

[0002] 薄膜电致发光显示器 (TFELD) 由于其主动发光、全固体化、耐冲击、反应快、视角大、适用温度宽、工序简单等优点, 已引起了广泛的关注, 且发展迅速。目前, 研究彩色及至全色 TFELD, 开发多波段发光的材料, 是该课题的发展方向。但是, 可应用于薄膜电致发光显示器的氟铜共掺杂硫化钙发光材料, 仍未见报道。

【发明内容】

[0003] 基于此, 有必要提供一种可应用于薄膜电致发光器件的氟铜共掺杂硫化钙发光材料、其制备方法、氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜、其制备方法、使用该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的薄膜电致发光器件及其制备方法。

[0004] 一种氟铜共掺杂硫化钙发光材料, 其化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$, 其中 CaS 是基质, Cu 元素是激活元素, $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0005] 一种氟铜共掺杂硫化钙发光材料的制备方法, 包括以下步骤:

[0006] 根据 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS, CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀, 其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$; 及

[0007] 将混合均匀的粉体在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时即得到化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 的氟铜共掺杂硫化钙发光材料。

[0008] 一种氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜, 该氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$, 其中, CaS 是基质, Cu 元素是激活元素, $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0009] 一种氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的制备方法, 包括以下步骤:

[0010] 根据 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS, CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时制成靶材, 其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$;

[0011] 将所述靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$; 及

[0012] 调整磁控溅射镀膜工艺参数为: 基靶间距为 $50\text{mm} \sim 90\text{mm}$, 磁控溅射工作压强 $0.2\text{Pa} \sim 1.5\text{Pa}$, 工作气体的流量为 $15\text{sccm} \sim 20\text{sccm}$, 衬底温度为 $200^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$, 接着进行制膜, 得到化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜。

[0013] 在优选的实施例中, 还包括步骤: 将所述氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜于 $500^\circ\text{C} \sim 800^\circ\text{C}$ 下真空退火处理 $0.5\text{h} \sim 3\text{h}$ 。

[0014] 在优选的实施例中, 所述真空腔体的真空度为 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$, 基靶间距为 60mm , 磁

控溅射工作压强为 1Pa, 工作气体为氩气, 工作气体的流量为 20sccm, 衬底温度为 450℃。

[0015] 一种薄膜电致发光器件, 该薄膜电致发光器件包括依次层叠的衬底、阳极层、发光层以及阴极层, 所述发光层的材料为氟铜共掺杂硫化钙发光材料, 该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$, 其中 $0.005 \leq x \leq 0.05, 0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0016] 一种薄膜电致发光器件的制备方法, 包括以下步骤:

[0017] 提供具有阳极的衬底;

[0018] 在所述阳极上形成发光层, 所述发光层的材料为氟铜共掺杂硫化钙发光材料, 该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$, 其中 $0.005 \leq x \leq 0.05, 0.001 \leq y \leq 0.03$;

[0019] 在所述发光层上形成阴极。

[0020] 在优选的实施例中, 所述发光层的制备包括以下步骤:

[0021] 根据 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS , CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材, 其中 $0.005 \leq x \leq 0.05, 0.001 \leq y \leq 0.03$;

[0022] 将所述靶材以及所述衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空间度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$;

[0023] 调整磁控溅射镀膜工艺参数为: 基靶间距为 $50\text{mm} \sim 90\text{mm}$, 磁控溅射工作压强 $0.2\text{Pa} \sim 1.5\text{Pa}$, 工作气体的流量为 $15\text{sccm} \sim 20\text{sccm}$, 衬底温度为 $200^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$, 接着进行制膜, 在所述阳极上形成发光层。

[0024] 在优选的实施例中, 所述发光层的制备还包括步骤: 将所述发光层于 $500^\circ\text{C} \sim 800^\circ\text{C}$ 下真空退火处理 $0.5\text{h} \sim 3\text{h}$ 。

[0025] 上述氟铜共掺杂硫化钙发光材料 ($\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$) 中, CaS 是基质, Cu 元素是激活元素, 在发光材料中充当主要的发光中心, F 离子的掺杂能够使发光材料产生大量的空穴, 起增强发光速率的作用, 氟铜共掺杂硫化钙发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱 (EL) 中, 在 437nm 波长区都有很强的蓝光发光峰, 能够应用于薄膜电致发光显示器中。

【附图说明】

[0026] 图 1 为一实施方式的薄膜电致发光器件的结构示意图;

[0027] 图 2 为实施例 1 制备的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的电致发光谱图;

[0028] 图 3 为实施例 1 制备的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的 XRD 图。

【具体实施方式】

[0029] 下面结合附图和具体实施例对氟铜共掺杂硫化钙发光材料、其制备方法、氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜、其制备方法、薄膜电致发光器件及其制备方法进一步阐明。

[0030] 一实施方式的氟铜共掺杂硫化钙发光材料, 其化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$, 其中, CaS 是基质, Cu 元素是激活元素, $0.005 \leq x \leq 0.05, 0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0031] 优选的, x 为 0.025 , y 为 0.01 。

[0032] 该氟铜共掺杂硫化钙发光材料中 CaS 是基质, Cu 元素是激活元素在发光材料中充当主要的发光中心, F 离子的掺杂能够使发光材料产生大量的空穴, 起增强发光速率的作

用。该氟铜共掺杂硫化钙发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱 (EL) 中, 在 437nm 波长区都有很强的发光峰, 能够应用于薄膜电致发光显示器中。

[0033] 上述氟铜共掺杂硫化钙发光材料的制备方法, 包括以下步骤:

[0034] 步骤 S11、根据 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS , CuS 和 CaF_2 粉体, 其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0035] 该步骤中, 优选的, x 为 0.025, y 为 0.01。

[0036] 可以理解, 该步骤中也可称取 CaS , CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀, 其中 CuS 的摩尔百分含量为 0.5%~5%, CaF_2 的摩尔百分含量为 0.05%~1.5%, 余量为 CaS 。优选的, CuS 的摩尔百分含量为 2.5%, CaF_2 的摩尔百分含量为 0.5%。

[0037] 步骤 S12、将混合均的粉体在 900°C~1300°C 下烧结 0.5 小时~5 小时即可得到化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 的氟铜共掺杂硫化钙发光材料。

[0038] 该步骤中, 优选的在 1200°C 下烧结 3 小时。

[0039] 一实施方式的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜, 该氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$, 其中, CaS 是基质, Cu 元素是激活元素, $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0040] 优选的, x 为 0.025, y 为 0.01。

[0041] 上述氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的制备方法, 包括以下步骤:

[0042] 步骤 S21、按 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS , CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀在 900°C~1300°C 下烧结 0.5 小时~5 小时制成靶材, 其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0043] 该步骤中, 优选的, x 为 0.025, y 为 0.01, 在 1250°C 下烧结 3 小时成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材。

[0044] 可以理解, 该步骤中也可称取 CaS , CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀, 其中 CuS 的摩尔百分含量为 0.5%~5%, CaF_2 的摩尔百分含量为 0.05%~1.5%, 余量为 CaS 。优选的, CuS 的摩尔百分含量为 2.5%, CaF_2 的摩尔百分含量为 0.5%。

[0045] 步骤 S22、将步骤 S21 中得到的靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空中度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 。

[0046] 该步骤中, 优选的, 真空度为 $5 \times 10^{-4}\text{Pa}$ 。衬底为铟锡氧化物玻璃 (ITO), 可以理解, 在其他实施例中, 也可以为掺氟氧化锡玻璃 (FTO)、掺铝的氧化锌 (AZO) 或掺铟的氧化锌 (IZO)。

[0047] 步骤 S23、调整磁控溅射镀膜工艺参数为: 基靶间距为 50mm~90mm, 磁控溅射工作压强 0.2Pa~1.5Pa, 工作气体的流量为 15sccm~20sccm, 衬底温度为 200°C~500°C; 接着进行制膜, 得到化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜。

[0048] 该步骤中, 优选的基靶间距为 60mm, 磁控溅射工作压强 1Pa, 工作气体为氩气, 工作气体的流量为 20sccm, 衬底温度为 450°C。

[0049] 步骤 S24、将氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜于 500°C~800°C 下真空退火处理 0.5h~3h。

[0050] 该步骤中, 优选的, 薄膜样品在 650°C 下真空退火处理 1h。

[0051] 请参阅图 1, 一实施方式的薄膜电致发光器件 100, 该薄膜电致发光器件 100 包括

依次层叠的衬底 1、阳极 2、发光层 3 以及阴极 4。

[0052] 衬底 1 为玻璃衬底。阳极 2 为形成于玻璃衬底上的氧化铟锡 (ITO)。发光层 3 的材料为氟铜共掺杂硫化钙发光材料，该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ ，其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。阴极 4 的材质为银 (Ag)。

[0053] 上述薄膜电致发光器件的制备方法，包括以下步骤：

[0054] 步骤 S31、提供具有阳极 2 的衬底 1。

[0055] 本实施方式中，衬底 1 为玻璃衬底，阳极 2 为形成于玻璃衬底上的氧化铟锡 (ITO)。具有阳极 2 的衬底 1 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗并用对其进行氧等离子处理。

[0056] 步骤 S32、在阳极 2 上形成功能层 3，发光层 3 的材料为氟铜共掺杂硫化钙发光材料，该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ ，其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0057] 本实施方式中，发光层 3 由以下步骤制得：

[0058] 首先，根据 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ 各元素的化学计量比称取 CaS 、 CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材，其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$, $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。

[0059] 该步骤中，优选的， x 为 0.025 , y 为 0.01 ，在 1250°C 下烧结 3 小时成直径为 50mm ，厚度为 2mm 的陶瓷靶材。

[0060] 可以理解，该步骤中也可称取 CaS 、 CuS 和 CaF_2 粉体并混合均匀，其中 CuS 的摩尔百分含量为 $0.5\% \sim 5\%$ ， CaF_2 的摩尔百分含量为 $0.05\% \sim 1.5\%$ ，余量为 CaS 。优选的， CuS 的摩尔百分含量为 2.5% ， CaF_2 的摩尔百分含量为 0.5% 。

[0061] 其次，将靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体，并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 。

[0062] 该步骤中，优选的，真空度为 $5 \times 10^{-4}\text{Pa}$ 。

[0063] 然后，调整磁控溅射镀膜工艺参数为：基靶间距为 $50\text{mm} \sim 90\text{mm}$ ，磁控溅射工作压强 $0.2\text{Pa} \sim 1.5\text{Pa}$ ，工作气体的流量为 $15\text{sccm} \sim 20\text{sccm}$ ，衬底温度为 $200^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$ ，接着进行制膜，在阳极 2 上形成功能层 3。

[0064] 该步骤中，优选的基靶间距为 60mm ，磁控溅射工作压强 1Pa ，工作气体为氩气，工作气体的流量为 20sccm ，衬底温度为 450°C 。

[0065] 最后、将发光层 3 于 $500^\circ\text{C} \sim 800^\circ\text{C}$ 下真空退火处理 $0.5\text{h} \sim 3\text{h}$ 。

[0066] 该步骤中，优选的，薄膜样品在 650°C 下真空退火处理 1h 。

[0067] 步骤 S33、在发光层 3 上形成阴极 4。

[0068] 本实施方式中，阴极 4 的材料为银 (Ag)，由蒸镀形成。

[0069] 下面为具体实施例。

[0070] 实施例 1

[0071] 选用纯度为 99.99% 的粉体，将 CaS 、 CuS 和 CaF_2 以摩尔比 $97 : 2.5 : 0.5$ 均匀混合后，在 1200°C 下烧结成直径为 50mm ，厚度为 2mm 的陶瓷靶材，并将靶材装入真空腔体内。并将靶材装入真空腔体内。然后，先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底，并用对其进行氧等离子处理，放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm 。用机

械泵和分子泵把腔体的真空中度抽到 5.0×10^{-4} Pa, 工作气体氩气的气流量为 20sccm, 压强调节为 1.0Pa, 衬底温度为 450℃。得到的样品在 0.01Pa 真空炉中退火 1h, 退火温度为 650℃, 得到化学式为 CaS:0.025Cu²⁺, 0.01F⁻ 的发光薄膜。然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0072] 本实施例中得到的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的化学通式为 CaS:0.025Cu²⁺, 0.01F⁻, 其中 CaS 是基质, Cu 元素是激活元素。

[0073] 请参阅图 2, 图 2 所示为得到的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的电致发光谱 (EL)。由图 2 可以看出, 电致发光谱中, 在 437nm 波长区都有很强的发光峰, 能够应用于薄膜电致发光显示器中。

[0074] 请参阅图 3, 图 3 为实施例 1 制备的氟铜共掺杂硫化钙发光薄膜的 XRD 曲线, 测试对照标准 PDF 卡片。从图 3 中可以看出, 所有的衍射峰都是硫化钙相关的特征峰, 没有出现掺杂元素以及其它杂质的衍射峰, 证明掺杂元素是进入了硫化钙的晶格。

[0075] 实施例 2

[0076] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 CaS, CuS 和 CaF₂ 以摩尔比 99.45 : 0.5 : 0.05 均匀混合后, 在 900℃ 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 50mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空中度抽到 1.0×10^{-5} Pa, 工作气体氩气的气流量为 25sccm, 压强调节为 1.5Pa, 衬底温度为 500℃。得到的样品在 0.01Pa 真空炉中退火 1h, 退火温度为 800℃, 得到化学式为 CaS:0.005Cu²⁺, 0.001F⁻ 的发光薄膜。然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0077] 实施例 3

[0078] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 CaS, CuS 和 CaF₂ 以摩尔比 93.5 : 5 : 1.5 均匀混合后, 在 1300℃ 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 90mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空中度抽到 1.0×10^{-3} Pa, 工作气体氩气的气流量为 15sccm, 压强调节为 0.2Pa, 衬底温度为 250℃。得到的样品在 0.01Pa 真空炉中退火 1h, 退火温度为 500℃, 得到化学式为 CaS:0.05Cu²⁺, 0.03F⁻ 的发光薄膜。然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0079] 实施例 4

[0080] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 CaS, CuS 和 CaF₂ 以摩尔比 97 : 2 : 1 均匀混合后, 在 1300℃ 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 90mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空中度抽到 1.0×10^{-3} Pa, 工作气体氩气的气流量为 15sccm, 压强调节为 0.2Pa, 衬底温度为 250℃。得到的样品在 0.01Pa 真空炉中退火 1h, 退火温度为 500℃, 得到化学式为 CaS:0.02Cu²⁺, 0.02F⁻ 的发光薄膜。然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0081] 实施例 5

[0082] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 CaS, CuS 和 CaF₂ 以摩尔比 98 : 1.5 : 0.5 均匀混合后, 在 1300℃下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 90mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空中抽到 1.0×10^{-3} Pa, 工作气体氩气的气流量为 15sccm, 压强调节为 0.2Pa, 衬底温度为 250℃。得到的样品在 0.01Pa 真空炉中退火 1h, 退火温度为 500℃, 得到化学式为 CaS:0.015Cu²⁺, 0.01F⁻ 的发光薄膜。然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0083] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式, 其描述较为具体和详细, 但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是, 对于本领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若干变形和改进, 这些都属于本发明的保护范围。因此, 本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

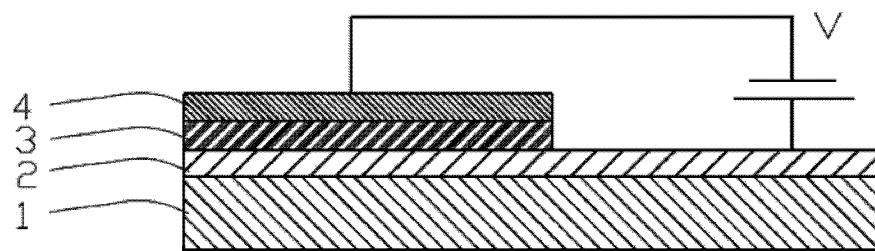


图 1

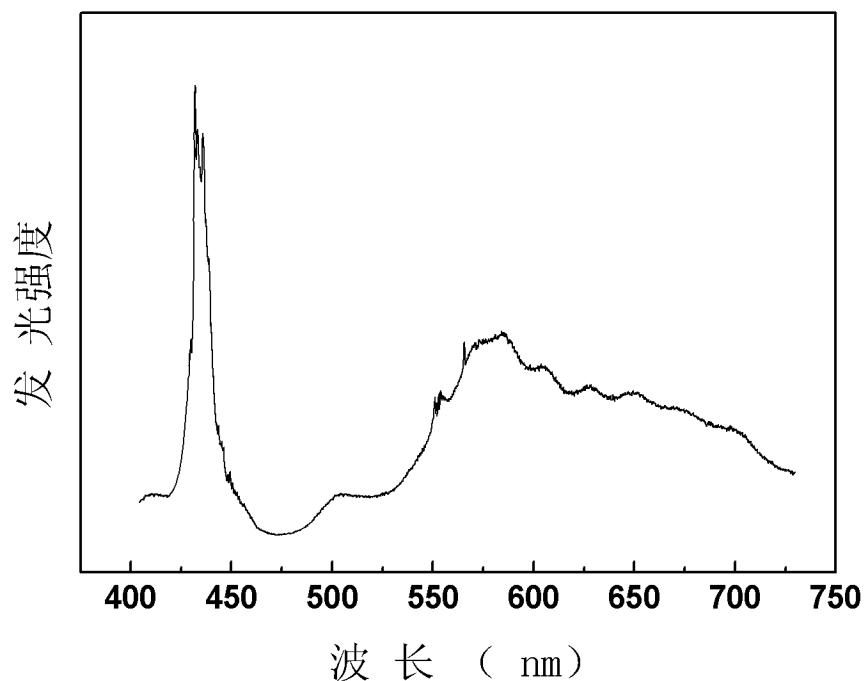


图 2

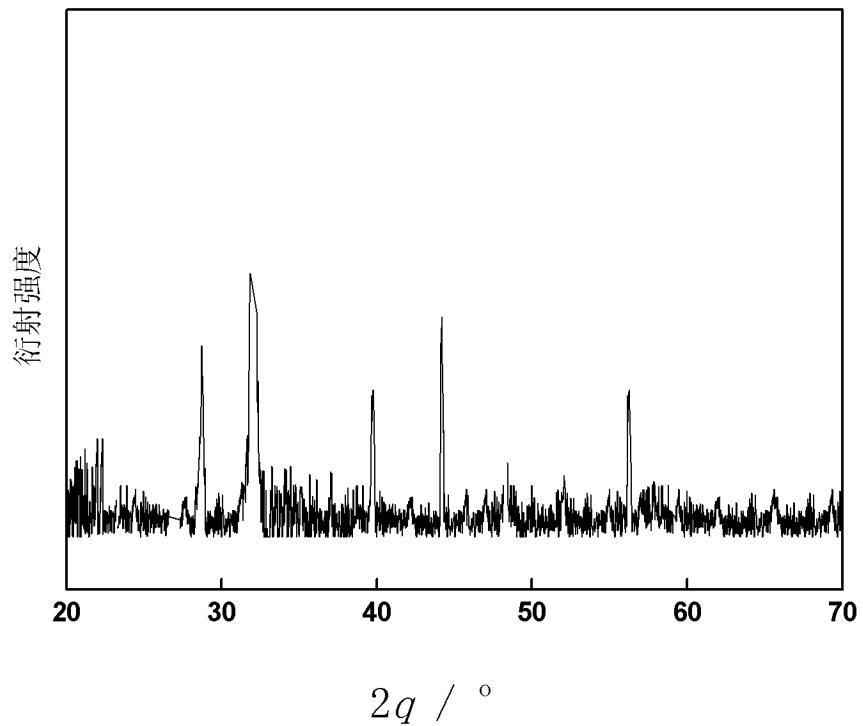


图 3

专利名称(译)	氟铜共掺杂硫化钙发光材料、制备方法及其应用		
公开(公告)号	CN103289682A	公开(公告)日	2013-09-11
申请号	CN201210047862.0	申请日	2012-02-28
[标]申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司		
[标]发明人	周明杰 王平 陈吉星 黄辉		
发明人	周明杰 王平 陈吉星 黄辉		
IPC分类号	C09K11/56 H01L33/50		
代理人(译)	何平		
其他公开文献	CN103289682B		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

一种氟铜共掺杂硫化钙发光材料，其化学式为 $\text{CaS}:x\text{Cu}^{2+}, y\text{F}^-$ ，其中 $0.005 \leq x \leq 0.05$ ， $0.001 \leq y \leq 0.03$ 。该氟铜共掺杂硫化钙发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱(EL)中，在437nm波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该氟铜共掺杂硫化钙发光材料的制备方法及其应用。

